

nichetech

骏码科技于2006年成立，由周振基教授及周博轩先生创建而成的创新科技公司。公司服务于半导体和微电子封装行业，专注研发先进材料，为半导体封装、LED封装和COB封装厂商引入创新的解决方案；专业设计、生产和销售全系列的键合线、封装硅胶、环氧树脂封装胶以及粘合剂等专用物料。

骏码科技专门提供先进的铜键合线材，不但具有显著成本效益，同时亦具有传统金键合丝的导电性能，是极优秀的半导体封装材料。铜键合丝电阻率低，有利于应用在QFP、QFN和SOIC产品上；高电阻会对电路性能带来负面影响，使用骏码科技铜键合丝可提供更佳的改善。

骏码科技的LED灯丝成型封装硅胶为成型高触变性半球形状，产品附着性好，强度适中，因为触变性高，适用于LED灯丝灯、COB等产品的封装。产品对玻璃、铝、陶瓷、银、PPA等黏结性能优异，产品固化后成型性能好，透光率好，流明度高，高温不冒油不起雾，热稳定性优异。

骏码科技COB环氧树脂封装胶是高纯度封装材料，专门研发给COB产业应用。公司的COB环氧树脂封装胶能有较调控及完全浸透于焊接键合线之间，在现代化高端电子设备产品之中广泛使用。

骏码科技的焊锡材料包括锡线，锡膏和锡条。公司的焊锡材料应用于印刷电路板上，电子零件的封装焊接。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/nichetec-964.html>